


Dell EMC PowerEdge T550

仕様詳細

注意:このコンテンツは、人工知能 (AI) を使用して翻訳されています。エラーが含まれている可能性があり、いかなる種類の保証もなく「現状のまま」提供されます。原文 (未翻訳) のコンテンツは、英語版をご覧ください。このコンテンツについてご質問やご不明な点がございましたら、Dell(Dell.Translation.Feedback@dell.com)までお問い合わせください。

メモ、注意、警告

 **メモ:** 「メモ」は、製品をより上手に使用するための重要な情報であることを示します。

 **注意:** 「注意」は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 「警告」は、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

章 1: 仕様詳細	4
シャーシ寸法.....	5
システムの重量.....	5
プロセッサの仕様.....	6
PSU の仕様.....	6
冷却ファンの仕様.....	7
対応オペレーティング システム.....	8
システムバッテリーの仕様.....	8
拡張カードライザーの仕様.....	8
メモリーの仕様.....	8
ストレージコントローラーの仕様.....	9
ドライブの仕様.....	9
ドライブ.....	9
光学ドライブ.....	9
ポートおよびコネクタの仕様.....	10
USB ポートの仕様.....	10
NIC ポートの仕様.....	10
VGA ポートの仕様.....	10
シリアル コネクタの仕様.....	10
ビデオの仕様.....	10
環境仕様.....	11
温度に関する制限のマトリックス.....	12
粒子状およびガス状汚染物質の仕様.....	15
温度通気の制限.....	16

仕様詳細

本項では、お使いのシステムの仕様詳細と環境仕様の概要を示します。

トピック：

- シャーシ寸法
- システムの重量
- プロセッサの仕様
- PSU の仕様
- 冷却ファンの仕様
- 対応オペレーティング システム
- システムバッテリーの仕様
- 拡張カードライザーの仕様
- メモリーの仕様
- ストレージコントローラーの仕様
- ドライブの仕様
- ポートおよびコネクタの仕様
- ビデオの仕様
- 環境仕様

シャーシ寸法

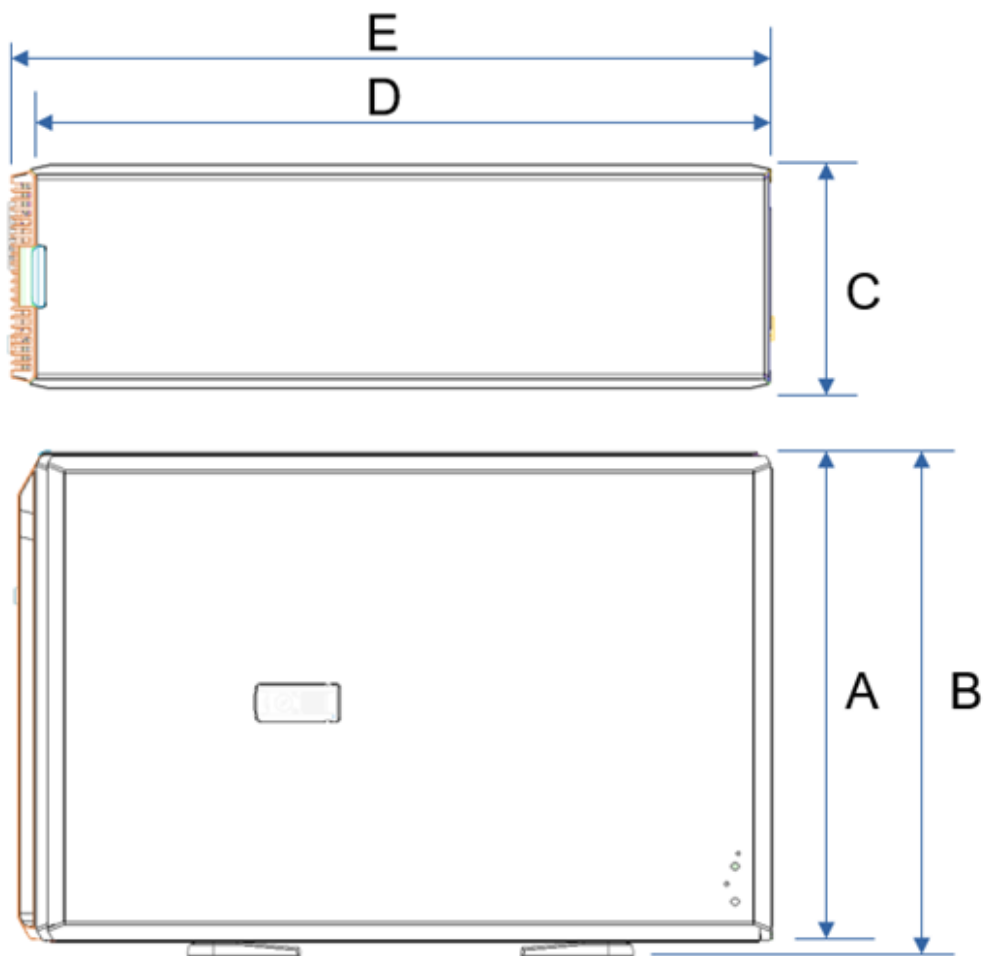


図 1. シャーシ寸法

表 1. システムのシャーシ寸法

ドライブ	A	B	C	D	E (ベゼルを含む)
24 x 2.5 インチ / 8 x 3.5 インチ + 8 x 2.5 インチ NVMe	446.0 mm (17.60 インチ)	464.0 mm (18.27 インチ)	200.0 mm (7.87 インチ)	663.5 mm (26.12 インチ)	680.5 mm (26.79 インチ)

①メモ: Zb は、システム ボード I/O コネクタが設置されている公称背面外部表面を示します。

システムの重量

表 2. PowerEdge T550 システムのシステム重量

システム設定	最大重量 (すべてのドライブ/SSD を含む)
8 x 3.5 インチ + 8 x 2.5 インチ NVMe	44.48 kg (98.06 ポンド)
24 x 2.5 インチ SAS/SATA	44.1 kg (97.22 ポンド)

プロセッサの仕様

表 3. システムのプロセッサの仕様

サポートされるプロセッサ	サポートされているプロセッサ数
第 3 世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサ (最大 32 コア)	最大 2 個

PSU の仕様

PowerEdge T550 システムでは、最大 2 台の AC 電源供給ユニット (PSU) がサポートされます。

表 4. PSU の仕様

PSU	クラス	熱消費 (最大)	周波数	電圧	AC		DC	現在
					高圧線 200~240 V	低圧線 100~120 V		
600 W 混合モード	ブラチナ	2250 BTU/時	50/60 Hz	100~240 V、オートレンジ	600 W	600 W	該当なし	7.1 A~3.6 A
	該当なし	2250 BTU/時	該当なし	DC 240 V	該当なし	該当なし	600 W	2.9 A
800 W 混合モード	ブラチナ	3000 BTU/時	50/60 Hz	100~240 V、オートレンジ	800 W	800 W	該当なし	9.2 A~4.7 A
	該当なし	3000 BTU/時	該当なし	DC 240 V	該当なし	該当なし	800 W	3.8 A
DC 1100 W	該当なし	4265 BTU/hr	該当なし	DC -48 V~DC -60 V	該当なし	該当なし	1100 W	27 A
1100 W 混在モード	チタニウム	4125 BTU/時	50/60 Hz	100~240 V	1100 W	1050 W	該当なし	12 A~6.3 A
	該当なし	4125 BTU/時	該当なし	DC 240 V	該当なし	該当なし	1100 W	5.2 A
1400 W 混合モード	ブラチナ	5250 BTU/時	50/60 Hz	100~240 V	1400 W	1050 W	該当なし	12 A~8 A
	該当なし	5250 BTU/時	該当なし	DC 240 V	該当なし	該当なし	1400 W	6.6 A
2400 W 混在モード	ブラチナ	9000 BTU/時	50/60 Hz	100~240 V	2400 W	1400 W	該当なし	16 A~13.5 A
	該当なし	9000 BTU/時	該当なし	DC 240 V	該当なし	該当なし	2400 W	11.2 A
700 W 混合モード	チタニウム	2625 BTU/時	50/60 Hz	200 ~ 240 V AC	700 W	NA	NA	4.1 A

表 4. PSU の仕様 (続き)

PSU	クラス	熱消費 (最大)	周波数	電圧	AC		DC	現在
					高圧線 200~ 240 V	低圧線 100~ 120 V		
	NA	2625 BTU/ 時	NA	DC 240 V	NA	NA	700 W	3.4 A
1800 W 混合 モード	チタニウム	6000 BTU/ 時	50/60 Hz	200 ~ 240 V AC	1800 W	NA	NA	10 A
	NA	6000 BTU/ 時	NA	DC 240 V	NA	NA	1800 W	8.2 A

- ① **メモ:** このシステムは、相間電圧が 240 V 以下の IT 電力システムに接続できるようにも設計されています。
- ① **メモ:** 熱消費は PSU のワット定格を使用して算出されています。
- ① **メモ:** システム構成を選択またはアップグレードする場合は、最適な電力使用率を達成できるように、Dell.com/calc で入手できる Enterprise Infrastructure Planning Tool でシステムの電力消費量を検証します。

冷却ファンの仕様

PowerEdge T550 システムでは、システム ボードに直接接続されている最大 8 台の標準またはハイ パフォーマンス シルバー グレード (HPR (Silver)) 冷却ファンがサポートされます。

表 5. 冷却ファンの仕様

ファンのタイプ	略語	別名	ラベルの色	ラベルの画像
[ハイパフォーマンス (シルバー グレード) ファン]	HPR (シルバー)	HPR: ハイ パフォーマンス	該当なし	 <p>図 2. ハイ パフォーマンス ファン</p>
[標準ファン]	STD	STD: 標準	該当なし	 <p>図 3. 標準ファン</p>

- ① **メモ:** サポートされるファンの構成またはマトリックスの詳細については、「[温度制限マトリックス](#)」を参照してください。

対応オペレーティング システム

PowerEdge T550 システムは、次のオペレーティング システムをサポートしています。

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix Hypervisor
- Hyper-V 搭載 Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi

詳細については、[OS サポート](#)を参照してください。

システムバッテリーの仕様

PowerEdge T550 システムは、CR 2032 3.0 V コイン型リチウム電池システム電池をサポートします。

拡張カードライザーの仕様

システムでは、最大 6 枚の PCI express (PCIe) Gen 4 拡張カードがサポートされます。

表 6. 拡張カード スロットのサポート マトリックス

PCIe スロット	プロセッサ- 1	プラットフォームコントローラハブ (PCH)	プロセッサ- 2
	内蔵	内蔵	内蔵
スロット 1	x16	-	-
スロット 2	-	-	x16
スロット 3	-	-	x16
スロット 4	-	-	x16
スロット 5	-	x8	-
スロット 6	x16	-	-

表 7. ライザー構成でサポートされている拡張カード スロット

PCIe スロット	ライザー構成	ライザーの幅	サポートされている PERC	サポートされている背面ストレージ
スロット 1	GPU ライザー	x16 PCIe	無	無
スロット 2	GPU ライザー	x16 PCIe	無	無

メモリーの仕様

システムは、作動を最適化するために次のメモリー仕様をサポートしています。

表 8. メモリーの仕様

DIMM のタイプ	DIMM のランク	DIMM の容量		DIMM の定格電圧およびサポートされる速度	速度	
		シングルプロセッサ	デュアルプロセッサ		シングルプロセッサ	デュアルプロセッサ
RDIMM	シングルランク	8 GB	16 GB	DDR4 (1.2 V)、3200	3200	2933
		16 GB	32 GB	DDR4 (1.2 V)、3200	3200	2933

表 8. メモリーの仕様 (続き)

DIMM のタイプ	DIMM のランク	DIMM の容量		DIMM の定格電圧およびサポートされる速度	速度	
		シングルプロセッサ	デュアルプロセッサ		シングルプロセッサ	デュアルプロセッサ
	デュアル ランク	16 GB	32 GB	DDR4 (1.2 V)、3200	3200	2933
		32 GB	64 GB	DDR4 (1.2 V)、3200	3200	2933

表 9. メモリモジュールソケット

メモリモジュールソケット	速度
16、288 ピン	3200 MT/秒、2933 MT/秒

ストレージコントローラーの仕様

PowerEdge T550 システムでは次のコントローラー カードがサポートされます。

表 10. ストレージ コントローラー カード

内部コントローラ	外部コントローラー
<ul style="list-style-type: none"> • S150 • PERC H345 • H355 • PERC H755 • H755N • HBA355i • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2) : HWRAID 2 x M.2 SSD 	<ul style="list-style-type: none"> • HBA355e • PERC H840

ドライブの仕様

ドライブ

PowerEdge T550 システムは次をサポートします。

- 最大 8 x 2.5 インチ SAS/SATA/ (HDD) ドライブ
- 最大 16 x 2.5 インチ SAS/SATA/ (HDD) ドライブ
- 最大 24 x 2.5 インチ SAS/SATA/ (HDD) ドライブ
- 最大 8 x 3.5 インチ SAS/SATA/ (HDD/SSD) ドライブ
- 最大 8 x 3.5 インチ SAS/SATA + 8 x 2.5 インチ NVMe (HDD/SSD) ドライブ

① **メモ:** NVMe PCIe SSD U.2 デバイスをホット スワップする方法の詳細については、[Dell サポート](#) ページの [全製品の閲覧] > [データセンター インフラストラクチャ] > [ストレージ アダプターとコントローラー] > [Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD] > [ドキュメント] > [マニュアルとドキュメント] から、[Dell Express Flash NVMe PCIe SSD ユーザーズ ガイド](#)を参照してください。

光学ドライブ

PowerEdge T550 システムでは、スリム SATA DVD-ROM ドライブが 1 台サポートされます。

① **メモ:** DVD デバイスはデータのみをサポートします。

ポートおよびコネクタの仕様

USB ポートの仕様

表 11. USB の仕様

正面		背面	
USB ポートタイプ	数ポート数	USB ポートタイプ	数ポート数
USB 2.0 対応ポート	1回	USB 3.0 対応ポート	1回
USB 3.0 対応ポート	1回	USB 2.0 対応ポート	1回
iDRAC ダイレクトポート (Micro-AB USB 2.0 対応ポート)	1回		

- ① **メモ:** 前面 micro USB 2.0 対応ポートは、アップセル構成でのみ使用可能です。
- ① **メモ:** Micro USB 2.0 対応ポートは、iDRAC ダイレクトまたは管理ポートとしてのみ使用できます。
- ① **メモ:** USB 2.0 の仕様では、単一のワイヤに 5 V の電力を供給して、接続されている USB デバイスに電源を供給します。ユニットのロードは、USB 2.0 では 100 mA、USB 3.0 では 150 mA に定義されています。デバイスでは、USB 2.0 のポートから最大 5 ユニットロード (500 mA) を引き出し、USB 3.0 のポートから最大 6 ユニットロード (900 mA) を引き出す可能性があります。
- ① **メモ:** USB 2.0 のインターフェイスにより、低電力の周辺機器類に電力を供給できますが、USB の仕様に準拠している必要があります。外部の CD/DVD ドライブといった高電力の周辺機器類を機能させるには、外部の電源が必要です。

NIC ポートの仕様

システムは、最大 2 個の 10/100/1000 Mbps ネットワーク インターフェイス コントローラー (NIC) ポート (LAN on Motherboard (LOM) に組み込まれたポートと、オプションの OCP カードに内蔵されたポート) を備えています。

表 12. システムの NIC ポートの仕様

特長	仕様
LOM カード	2 x 1 GB
OCP カード (OCP 3.0)	4 x 1 GbE、2 x 10 GbE、2 x 25 GbE、4 x 25 GbE、2 x 50 GbE、2 x 100 GbE

VGA ポートの仕様

システムは、1 回個の DB-15 VGA ポート (前面パネルおよび背面パネルに各 1 個) をサポートしています。

シリアル コネクタの仕様

PowerEdge T550 システムは、1 x オプションのカード タイプ シリアル コネクタをサポートしています。このコネクタは、9 ピン コネクタ、データ端末装置 (DTE)、16550 準拠です。

オプションのシリアル コネクタ カードは、拡張カード フィラーブラケットと同じ手順で取り付けられます。

ビデオの仕様

システムは、16 MB のビデオ フレーム バッファを備える内蔵 Matrox G200 グラフィックス コントローラーをサポートしています。

表 13. システムでサポートされている背面ビデオ解像度のオプション

解像度	リフレッシュレート (Hz)	色深度 (ビット)
1024 x 768	60	8、16、32
1280 x 800	60	8、16、32
1280 x 1024	60	8、16、32
1360 x 768	60	8、16、32
1440 x 900	60	8、16、32
1600 x 900	60	8、16、32
1600 x 1200	60	8、16、32
1680 x 1050	60	8、16、32
1920 x 1080	60	8、16、32
1920 x 1200	60	8、16、32

環境仕様

① **メモ:** 環境証明の詳細については、Dell サポートの「マニュアルおよびドキュメント」にある『製品環境データシート』を参照してください。

表 14. 動作環境範囲カテゴリ A2

温度	仕様
許容可能な継続動作	
高度 <= 900 m (<= 2,953 ft) の温度範囲	10~35°C (50~95°F)、装置への直射日光なし
湿度範囲 (常に結露なし)	8% RH で最低露点-12°C~80% RH で最大露点 21°C (69.8°F)
動作高度減定格	900 m (2953 フィート) を越える高度では、最高温度は 300 m ごとに 1°C (984 フィートごとに 33.8°F) 低くなります。

表 15. 動作環境範囲カテゴリ A3

温度	仕様
許容可能な継続動作	
高度 <= 900 m (<= 2,953 ft) の温度範囲	5~40°C (41~104°F)、装置への直射日光なし
湿度範囲 (常に結露なし)	8% RH で最低露点-12°C~80% RH で最高露点 24°C (75.2°F)
動作高度減定格	900 m (2,953 Ft) を越える高度では、最高温度は 175 m ごとに 1°C (574 Ft ごとに 1.8°F) 低くなります。

表 16. 動作環境範囲カテゴリ A4

温度	仕様
許容可能な継続動作	
高度 <= 900 m (<= 2,953 ft) の温度範囲	5°C~45°C (41°F~113°F)、装置への直射日光なし
湿度範囲 (常に結露なし)	8% RH で最低露点-12°C~80% RH で最高露点 24°C (75.2°F)
動作高度減定格	900 m (2,953 Ft) を越える高度では、最高温度は 125 m ごとに 1°C (410 Ft ごとに 1.8°F) 低くなります。

① **メモ:** 特定のシステム ハードウェア構成では、作動時温度が 28°C 未満であることが必要な場合があります。詳細については、「温度通気の制限」の項を参照してください。

表 17. すべてのカテゴリに共通する要件

温度	仕様
許容可能な継続動作	
最大温度勾配（動作時と非動作時の両方に適用）	1 時間で 20°C*（1 時間で 36°F）、15 分間で 5°C（15 分間で 41°F）、テープの場合は 1 時間で 5°C*（1 時間で 41°F） ①メモ ：*：テープハードウェアの ASHRAE 温度ガイドラインにより、これらは温度変化の瞬間レートではありません。
非動作時の温度制限	-40~65°C（-104~149°F）
非動作時の湿度制限	5%~95% RH で最大露点 27°C（80.6°F）
非動作時の最大高度	12,000 メートル（39,370 フィート）
動作時の最大高度	3,048 メートル（10,000 フィート）

表 18. 最大振動の仕様

最大耐久震度	仕様
動作時	0.21 G _{rms} （5~500 Hz）（全稼働方向）
ストレージ	1.88 G _{rms} （10Hz~500 Hz）で 15 分間（全 6 面で検証済）

表 19. 最大衝撃パルス仕様

最大衝撃パルス	仕様
動作時	x、y、z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス、11 ミリ秒以下で 6 G。
ストレージ	x、y、z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス（システムの各面に対して 1 パルス）、2 ミリ秒以下で 71 G。

温度に関する制限のマトリックス

表 20. 温度に関する制限のマトリックス

ドライブ構成	プロセッサ	ファン	CPU TDP	ファン冗長性	CPU HSK		GPU のサポート		TBU のサポート	CPU ダミー	ファン ダミー	メモ	GPU ライザーの構成
					TDP>150 W	TDP<=150 W	GPU<=75 W	GPU>75 W					
8 x 3.5	1	STD x 3	<=185	無、STDx6 へのアップセル オプション	HPR HSK	STD HSK	無	無	無	有	有 (ファン 2 の場所)	ファン 1/3/4	ライザー 0、1
	1	STD x 6	<=220	有			無	無	無	有		ファン 1/3/4/5/7/8	ライザー 0、1
	1	HPR x 3	<=220	無、HPRx6 へのアップセル オプション			有	無	無	有		ファン 1/3/4	無
	1	HPR x 5*	<=220	有			はい/いいえ	無	有	有		ファン 1/3/4/7/8 (GPU ライザー 1 および 2 はサポートされていません)	無
	1	HPR x 6	<=220	有			有	有	無	有		ファン 1/3/4/5/7/8	有
	2	STD x 4	<=185	無、STDx8 へのアップセル オプション			無	無	無	無	無	NA	ライザー 0、1
	2	STD x 8	<=220	有			無	無	無	無	NA	ライザー 0、1	
	2	HPR x 4	<=220	無、HPRx8 へのアップセル オプション			有	無	無	無	NA	無	
	2	HPR x 7*	<=220	TBD			はい/いいえ	無	有	無	ファン 1/2/3/4/6/7/8 ①メモ: GPU ライザー 1 および 2 はサポートされていません	無	
	2	HPR x 8	<=220	有			有	有	無	無	NA	有	

表 20. 温度に関する制限のマトリックス (続き)

ドライブ構成	プロセッサ	ファン	CPU TDP	ファン冗長性	CPU HSK		GPU のサポート		TBU のサポート	CPU ダミー	ファン ダミー	メモ	GPU ライザーの構成
					TDP>150 W	TDP<=150 W	GPU<=75 W	GPU>75 W					
2.5 x 8 16 x 2.5 24 x 2.5	1または2	STD x 4	<=185	無、STDx8へのアップセルオプション	HPR HSK	STD HSK	無	無	無	プロセッサ1台の場合は有	無	NA	ライザー 0、1
	1または2	STD x 8	<=220	有			無	無	無			NA	ライザー 0、1
	1または2	HPR x 4	<=220	無、STDx8へのアップセルオプション			有	無	無			NA	無
	1または2	HPR x 7*	<=220	有			はい/いいえ	無	有			ファン 1/2/3/4/6/7/8 ①メモ: GPU ライザー 1および2はサポートされていません	無
	1または2	HPR x 8	<=220	有			有	有	無				
8 x 3.5 + 8 x 2.5 (NVMe)	1または2	HPR x 4	<=220	無、HPRx8へのアップセルオプション	HPR HSK	STD HSK	有	無	無	プロセッサ1台の場合は有	無	NA	ライザーなし、またはライザー 0、1、2
	1または2	HPR x 7*	<=220	有			はい/いいえ	無	有			ファン 1/2/3/4/6/7/8 ①メモ: GPU ライザー 1および2はサポートされていません	無
	1または2	HPR x 8	<=220	有			有	有	無				

- ① **メモ:** OCP カードが取り付けられていない場合でも、すべてのドライブ構成に OCP エアフローカバーが必要です。
- ① **メモ:** CPU TDP>185 W の場合は DIMM ダミーが必要ですが、CPU TDP<=185 W には必要ありません。
- ① **メモ:** GPU ライザー スロット 1 に GPU>75 W が取り付けられている場合、GPU ライザー スロット 2 には GPU ダミーが必要です。
- ① **メモ:** 空の HDD スロットには HDD ダミーが必要です。
- ① **メモ:** * 5 台と 7 台のファン台数は、TBU 構成にのみ適用できます。TBU のないシステムでは、ファンの台数を 5 台と 7 台にしないでください。TBU 構成の場合、周囲温度は 35°C より低くなります。
- ① **メモ:** GPU を選択する場合は、HPR ファンが必要です。
- ① **メモ:** GPU>75W にはファンの冗長性が必要です (ファン数= 6 または 8)。
- ① **メモ:** GPU>75 W では TBU はサポートされていません。
- ① **メモ:** STD ファンは、HPR ファンにアップグレードをすることもできます。

すべての構成に対する温度マトリックス

表 21. すべての構成に対する温度マトリックス

-		8 x、16 x、24 x 2.5 インチ SAS/SATA 構成 1				8 x 3.5 インチ構成 2				8 x 3.5 インチ+ 8 x 2.5 インチ NVMe 構成 3	
[ファン]		STD x 4	STD x 8	HPR x 4	HPR x 7 x 8	STD x 3 x 4	STD x 6 x 8	HPR x 3 x 4	HPR x 5 x 6 x 7 x 8	HPR x 4	HPR x 7 x 8
[ファン冗長性]		無	有	無	有	無	有	無	有	無	有
[最大 DIMM 電力]		12 W	12 W	12 W	12 W	12 W	12 W	12 W	12 W	12 W	12 W
[CPU TDP]	105 W	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK
	120 W	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK
	125 W	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK
	135 W	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK
	150 W	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK
	165 W	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK
	185 W	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK
	205 W	非対応	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	非対応	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK
220 W	非対応	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	非対応	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	

粒子状およびガス状汚染物質の仕様

次の表は、粒子汚染およびガス状汚染物による IT 装置の損傷または故障またはその両方を避けるために役立つ制限事項を定義しています。粒子汚染またはガス汚染のレベルが指定された制限を超え、機器の損傷または故障の原因となる場合、環境条件の変更が必要になります。環境状態の修復は、お客様の責任となります。

表 22. 粒子状汚染物質の仕様

粒子汚染	仕様
空気清浄	<p>データセンターの空気清浄レベルは、ISO 14644-1 の ISO クラス 8 の定義に準じて、95% 上限信頼限界です。</p> <p>① メモ: この条件はデータセンターの環境にのみ適用されます。空気清浄要件は、事務所や工場現場などのデータセンター外での使用のために設計された IT 装置には適用されません。</p> <p>① メモ: データセンターに吸入される空気は、MERV11 または MERV13 フィルタで濾過する必要があります。</p>
伝導性ダスト	<p>空気中に伝導性ダスト、亜鉛ウイスカ、またはその他伝導性粒子が存在しないようにする必要があります。</p> <p>① メモ: この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。</p>
腐食性ダスト	<ul style="list-style-type: none"> • 空気中に腐食性ダストが存在しないようにする必要があります。 • 空気中の残留ダストは、潮解点が相対湿度 60% 未満である必要があります。 <p>① メモ: この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。</p>

表 23. ガス状汚染物質の仕様

ガス状汚染物	仕様
銅クーポン腐食度	クラス G1 (ANSI/ISA71.04-2013 の定義による) に準じ、ひと月あたり 300 Å 未満。
銀クーポン腐食度	ANSI/ISA71.04-2013 の定義に準じ、ひと月あたり 200 Å 未満

① **メモ:** 50% 以下の相対湿度で測定された最大腐食汚染レベル

温度通気の制限

さまざまな構成に対する温度通気の制限

表 24. 8 x 3.5 インチ ドライブ構成

標準作動サポート (ASHRAE A2 準拠) ① メモ: 特に記載がない限り、すべてのオプションがサポートされます。	拡張環境 40° C の作動サポート (ASHRAE A3 準拠)	拡張環境 45° C の作動サポート (ASHRAE A4 準拠)
<ul style="list-style-type: none"> • 3 台または 4 台の STD ファンでは、TDP <= 185W のプロセッサのみがサポートされます • STD ファンの場合、次の OCP 3.0 および NIC では温度仕様 85C および電力 <= 1.2 W の光ケーブルのみがサポートされます <ul style="list-style-type: none"> ○ Broadcom OCP 3.0 QP 25G SFP28 ○ Broadcom PCIe QP 25G ○ NVIDIA CX6-LX PCIe デュアルポート 25G SFP28 (スロット 6) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 台または 4 台の STD ファン構成はサポートされていません。 • プロセッサ TDP > 120W で、6 台または 8 台の STD ファン構成はサポートされていません。 • TBU はサポートされていません。 • Dell 認定外の周辺機器カードおよびチャネルデバイス (FW) カードはサポートされていません。 • NIC 消費電力 >= 25 W はサポートされていません。例: CX6 カード。 • OCP 転送レート > 25G または冷却階層 > 10 はサポートされていません。 • 仕様 85C の光ファイバーケーブルが必要です。 	<ul style="list-style-type: none"> • STD ファン構成はサポートされていません。 • CPU TDP > 165 W で、3 台または 4 台の HPR ファン構成はサポートされていません。 • TBU はサポートされていません。 • BOSS M.2 モジュールはサポートされていません。 • Dell 認定外の周辺機器カードおよびチャネルデバイス (FW) カードはサポートされていません。 • NIC 消費電力 >= 25W。例: CX6 カード。 • OCP 転送レート > 25G または冷却階層 > 10 はサポートされていません。 • 仕様 85C の光ファイバーケーブルが必要です。

表 24. 8 x 3.5 インチドライブ構成

標準作動サポート (ASHRAE A2 準拠)	拡張環境 40°C の作動サポート (ASHRAE A3 準拠)	拡張環境 45°C の作動サポート (ASHRAE A4 準拠)
<p>①メモ: 特に記載がない限り、すべてのオプションがサポートされます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2 個の PSU が必要です。PSU の障害が発生した場合、システム パフォーマンスが低下する可能性があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 2 個の PSU が必要です。PSU の障害が発生した場合、システム パフォーマンスが低下する可能性があります。

表 25. 8 x 2.5 インチ、16 x 2.5 インチ、24 x 2.5 インチドライブ構成

標準作動サポート (ASHRAE A2 準拠)	拡張環境 40°C の作動サポート (ASHRAE A3 準拠)	拡張環境 45°C の作動サポート (ASHRAE A4 準拠)
<ul style="list-style-type: none"> 4 台の STD ファンでは、TDP<=185W のプロセッサのみがサポートされます STD ファンの場合、次の OCP 3.0 および NIC では温度仕様 85C および電力<=1.2 W の光ケーブルのみがサポートされます <ul style="list-style-type: none"> Broadcom OCP 3.0 QP 25G SFP28 Broadcom PCIe QP 25G NVIDIA CX6-LX PCIe デュアルポート 25G SFP28 (スロット 6) 	<ul style="list-style-type: none"> 4 台の STD ファン構成はサポートされていません。 CPU TDP > 120 W で、8 台の STD ファン構成はサポートされていません。 TBU はサポートされていません。 Dell 認定外の周辺機器カードおよびチャネル デバイス (FW) カードはサポートされていません。 NIC 消費電力>= 25 W はサポートされていません。例: CX6 カード。 OCP 転送レート> 25G または冷却階層> 10 はサポートされていません。 仕様 85C の光ファイバー ケーブルが必要です。 2 個の PSU が必要です。PSU の障害が発生した場合、システム パフォーマンスが低下する可能性があります。 	<ul style="list-style-type: none"> STD ファン構成はサポートされていません。 プロセッサ TDP > 165 W で、4 台の HPR ファン構成はサポートされていません。 TBU はサポートされていません。 BOSS M.2 モジュールはサポートされていません。 Dell 認定外の周辺機器カードおよびチャネル デバイス (FW) カードはサポートされていません。 NIC 消費電力>= 25W。例: CX6 カード。 OCP 転送レート> 25G または冷却階層> 10 はサポートされていません。 仕様 85C の光ファイバー ケーブルが必要です。 2 個の PSU が必要です。PSU の障害が発生した場合、システム パフォーマンスが低下する可能性があります。

表 26. 8 x 3.5 インチ x 8 x NVMe ドライブ構成

標準作動サポート (ASHRAE A2 準拠)	拡張環境 40°C の作動サポート (ASHRAE A3 準拠)	拡張環境 45°C の作動サポート (ASHRAE A4 準拠)
<p>HPR ファンが必要です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> TBU はサポートされていません。 Dell 認定外の周辺機器カードおよびチャネル デバイス (FW) カードはサポートされていません。 NIC 消費電力>= 25 W はサポートされていません。例: CX6 カード。 OCP 転送レート> 25G または冷却階層> 10 はサポートされていません。 仕様 85C の光ファイバー ケーブルが必要です。 2 個の PSU が必要です。PSU の障害が発生した場合、システム パフォーマンスが低下する可能性があります。 	<ul style="list-style-type: none"> CPU TDP > 165 W で、4 台の HPR ファン構成はサポートされていません。 TBU はサポートされていません。 BOSS M.2 モジュールはサポートされていません。 Dell 認定外の周辺機器カードおよびチャネル デバイス (FW) カードはサポートされていません。 NIC 消費電力>= 25W。例: CX6 カード。 OCP 転送レート> 25G または冷却階層> 10 はサポートされていません。 仕様 85C の光ファイバー ケーブルが必要です。 2 個の PSU が必要です。PSU の障害が発生した場合、システム パフォーマンスが低下する可能性があります。